

第12世代Core™ プロセッサとQ670Eチップセットを搭載。ハイエンドGPU搭載可能な奥行き389mm。

画像処理・マシンビジョン向けミニタワー型 産業用PC
IPC-A670SAQ-MT

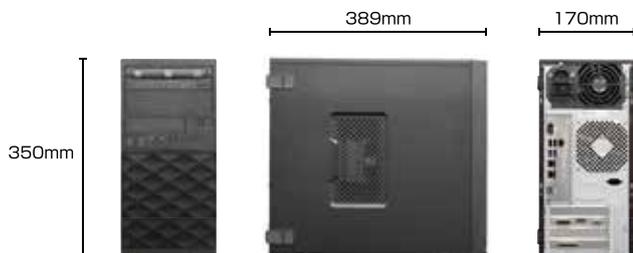
- 第12世代インテル® Core™ プロセッサ搭載
- インテル® Q670Eチップセット装備
- 組み込みに適したコンパクトサイズ
- COMポートを最大6基装備可能
- ハイエンドGPUボードが搭載可能
- 信頼性の高いニプロン電源を搭載
- 長期供給と安定稼働に優れたEmbedded構成



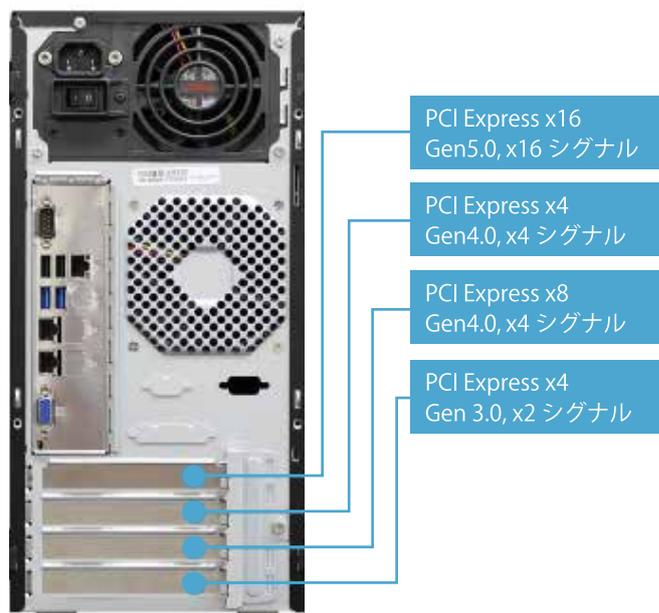
■製品仕様

モデル	IPC-A6705AQ-MT	
プロセッサ	種類	第12世代 インテル® Core™ プロセッサ
	搭載数	1
チップセット	インテル® Q670Eチップセット	
メモリー	規格	DDR5-4800 nECC
	容量	標準32GB (8GB×4) ※最大128GB (32GB×4)
	スロット数	4
ストレージ	5インチベイ	2
	3.5インチベイ	1
	3.5インチシャドーベイ	3
	2.5インチシャドーベイ	2
ODD	スリム型DVDスーパーマルチドライブ	
グラフィックス	インテル® UHD グラフィックス	
I/O	PS/2	1 (KB/Mouse)
	HDMI	1
	DisplayPort	1
	DVI-D	1
	VGA	1
	USB	前面 2 (USB2.0) 背面 2 (USB3.2, Gen2x1, TypeA)、2 (USB3.2, Gen2x2, TypeC)、2 (USB2.0)
	COM	2 (オプションで最大6まで可能)
	LAN	2 (2.5GbE)
	Audio	6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out)
拡張スロット	Slot4 : PCI-Express x16 (Gen 5.0, x16シグナル, CPU側) Slot3 : PCI-Express x4 (Gen 4.0, x4シグナル, PCH側) Slot2 : PCI-Express x8 (Gen 4.0, x4シグナル, PCH側) Slot1 : PCI-Express x4 (Gen 3.0, x2シグナル, PCH側)	
外形寸法	ミニタワー W170mm × D389mm × H350mm (突起物等を除く)	
重量	約8.5kg	
電源	ニプロン電源 822W (連続最大容量)/1000W (ピーク容量)	
利用環境	入力電圧	AC90V~240V
	温度	10℃~35℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)

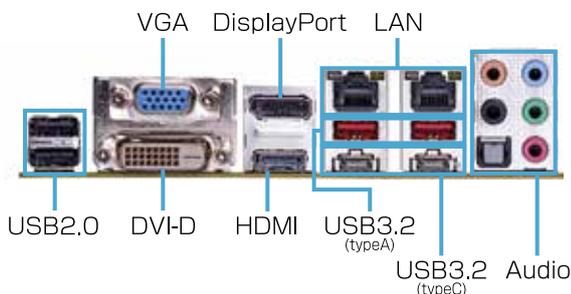
■外形寸法



■拡張スロット



■I/Oポート



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

2022年11月現在の内容です。